

## 詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與我們及我們的業務有關的若干技術詞彙。該等詞彙及其涵義未必與標準行業釋義或用法相符。

「2.5D封裝」	指	一種半導體封裝技術，將晶片並排設置於硅中介層上，實現晶片間的高頻寬互連
「3C／3C電子產品」	指	泛指廣泛應用於日常生活及工業領域的三大類電子產品（電腦、通訊及消費電子）的統稱
「3D封裝」	指	一種半導體封裝技術，透過垂直堆疊多顆晶片，相比傳統平面封裝可實現更高集成度及更短信號路徑
「ADB」	指	自適應行車光束，為先進汽車大燈技術，可即時自動調節光束模式，優化道路照明的同時避免對來車造成眩光
「AEC」	指	主動電纜，為配備集成主動元件的高速銅纜，有關主動元件可放大電信號，從而實現數據中心內部互連的直接信號傳輸
「AEC-Q200」	指	汽車電子委員會Q200標準，為適用於汽車應用的被動電子元件（如電阻器、電容器及電感器）應力測試認證的行業標準
「ASIC」	指	專用集成電路，為針對特定應用或功能定製設計及生產的微芯片，相比通用處理器具備更優化的性能
「CAD」	指	計算機輔助設計，指用於為工程、建築及製造應用創建實物精確二維或三維模型的軟件
「CAM」	指	計算機輔助製造，指透過計算機系統規劃、管理及控制製造流程的軟件，通常與CAD配合使用，將設計轉化為生產指令
「CNC」	指	計算機數值控制，一種透過預先編程的計算機軟件控制機械及切削刀具運動的製程，可實現高精度及自動化生產複雜零部件

## 詞彙表

「CPO」	指	共封裝光學，一種先進封裝技術，將光引擎與網絡交換專用集成電路直接整合於同一封裝基板上，以提升數據中心能源效率及帶寬密度
「DSP」	指	數碼信號處理器，一種專用微處理器芯片，其架構針對數碼信號處理運行需求優化，對流式數據執行快速數學運算
「DWDM」	指	密集波分複用，一種光網絡技術，利用間距緊密的激光波長將大量光載波信號複用於單條光纖，顯著提升傳輸容量
「ELS」	指	外部光源，一種光學元件，於外部產生激光並透過光纖連接輸送至光子集成電路或光引擎，將光產生與數據調變功能分離
「EMC」	指	電磁兼容，指電子設備或系統在其所處電磁環境中按設計正常運行，且不會產生或承受電磁幹擾的能力
「EML」	指	電吸收調制激光器，為一種集成光電半導體元件，其將連續波激光二極管（通常為分佈式反饋激光器）與電吸收調制器(EAM)集成於單一芯片之上，主要用於在長距離光纖通信中產生高速、低啾啾光信號。
「eVTOL」	指	電動垂直起降飛行器，一種利用電力實現懸停、垂直起飛及降落的飛行器，主要用於城市空中交通及短途客運
「F5G」	指	第五代固網，由歐洲電信標準學會制定的下一代固網寬頻標準，為企業及住宅用戶提供超高頻寬、全光纖連接及提升服務質素
「F5G-A」	指	第五代增強型固網，為F5G技術的升級版本，具備更強固網能力，提供更高頻寬、更低時延及更優網絡智能
「FPC」	指	柔性印刷電路板，為建基於纖薄柔性聚合物基板的電子電路的一種，可彎曲、折疊或扭轉，以安裝於緊湊及形狀不規則的電子設備內

## 詞彙表

「FPGA」	指	現場可編程邏輯閘陣列，為一種具高度靈活性的半導體元件，工程師可於其製成後配置內部邏輯單元及佈線電路，從而為專用計算任務實現定制硬件加速及快速原型開發
「FRO」	指	全重定時光學模組，為一種光收發模組，在發送及接收路徑均配備數字信號處理器(DSPs)，可對數據信號進行重定時、重塑形及再放大，以確保高速網絡通信中的最佳信號完整性
「FTTX」	指	光纖到點，為各類光纖網絡架構的統稱(包括光纖到戶、光纖到大樓、光纖到節點等)，將寬頻連接自網絡主幹延伸至接近或到達最終用戶處所
「IP67」	指	防護等級67，為IEC 60529標準下的防護評級，代表完全防塵(6級)，且可在水深1米內臨時浸泡30分鐘而不受損(7級)
「IP68」	指	防護等級68，為IEC 60529標準下的防護評級，代表完全防塵(6級)，且可在廠商指定條件下持續浸入超過1米水深而不受損(8級)
「IP6K9K」	指	防護等級6K9K，為ISO 20653標準下專用於汽車的防護評級，代表完全防塵(6K級)，且可抵擋高壓高溫蒸汽噴射清潔(9K級)
「LIN」	指	局域互連網絡，一種串列通訊協定，用於汽車及工業領域，實現傳感器、執行器與電子控制單元之間的低成本、低速聯網
「LPO」	指	線性驅動可插拔光模塊，為一種光模塊技術，透過線性類比信號傳輸省去數碼信號處理器(DSP)，顯著降低數據中心互連中的功耗及時延
「LRO」	指	線性接收光模塊，為一種光模塊技術，於光鏈路接收端採用線性驅動類比處理，相較傳統基於數碼信號處理器的模組，可簡化信號路徑並降低功耗
「MCU」	指	微控制器，為緊湊型集成電路，包含處理器核心、存儲器及可編程輸入輸出外圍設備，專為控制嵌入式系統內特定操作而設計

## 詞彙表

「MEMS」	指	微機電系統，為透過微加工技術將微型機械及機電部件（如傳感器、執行器及結構）集成於硅基片上的技術
「MES」	指	製造執行系統，為用於生產運營的軟件系統，旨在實時監控、追蹤、記錄及控制由原材料至產成品的整個生產流程
「MOX」	指	金屬氧化物（半導體），為一種氣體感知技術，透過量度金屬氧化物薄膜於接觸目標氣體時的電阻變化以偵測有關氣體，廣泛應用於空氣質素及安全監測領域
「NEV」	指	新能源汽車，指全部或部分由電池電力、氫能燃料電池或插電式混合動力系統等新能源驅動的車輛，有別於傳統內燃機汽車
「新能源及智能網聯汽車」	指	結合車載傳感器、控制器、執行器及通訊網絡技術，實現車輛與人、其他車輛、道路及雲端之間智能信息交互的新一代汽車
「NPO」	指	近封裝光模塊，為一種光模塊架構，將光引擎置於電路板上交換機專用集成電路鄰近位置，相較傳統可插拔模組，可縮短信號路徑長度、降低功耗及時延
「NTC」	指	負溫度係數（熱敏電阻），為一種熱敏電阻，其電阻隨溫度上升而下降，廣泛應用於溫度感知、監控及電路保護領域
「OEM」	指	原設備製造商，指生產產品或零部件並由另一家公司採購後，以採購公司品牌銷售的企業
「光引擎」	指	於芯片層級將電信號轉換為光信號（及將光信號轉換為電信號）的高度集成光電模組，用於在高端網絡系統中實現超高帶寬、低延遲及節能的數據傳輸。
「OSFP」	指	八通道小型可插拔模組，為高密度下一代光收發模組規格，設計用於支持400G、800G、1.6T及更高數據傳輸速率，具備八條電子通道及高效熱管理特性

## 詞彙表

「OTA」	指	空中下載技術，指透過無線方式遙距向設備傳送及安裝軟件更新、固件修補程式及配置變更的技術，毋須實際接觸設備或使用線纜連接
「PAM4」	指	四級脈衝幅度調製，為一種信號調制技術，透過四種不同幅度級別於每個符號中編碼兩位數據
「PCB」	指	印刷電路板，為由絕緣材料製成的平板，其上蝕刻或印製導電銅線路，用於在電路中為電子元件提供機械支撐及電氣連接
「PON」	指	被動光網絡，為一種用於提供寬頻網絡接入的光纖通信技術，利用無源（不供電）光分路器將單條光纖信號分配至多個客戶終端
「PTC」	指	正溫度係數（熱敏電阻／加熱器），為一種陶瓷發熱元件或熱敏電阻，其電阻隨溫度上升急劇增加，可實現自調節加熱，廣泛應用於汽車車廂加熱器及電池熱管理等領域
「PWM」	指	脈衝寬度調製，為透過改變脈衝信號的佔空比（開關比例）以控制電力輸送至電子設備的技術，廣泛應用於馬達控制、LED調光及電力調節領域
「R290」	指	R290（丙烷），為一種天然碳氫化合物製冷劑，全球變暖潛能值極低（全球變暖潛能值為3），於製冷及空調系統中用作合成製冷劑的環保替代品
「SLM」	指	選擇性激光熔化，為一種增材製造（3D打印）工藝，採用高功率密度激光逐層完全熔化金屬粉末並使其熔合，直接由數碼模型製成緻密的三維金屬部件
「TGV」	指	玻璃通孔技術，透過形成微孔於玻璃基板內實現垂直電氣互連，為先進半導體、顯示器及傳感器應用提供緊湊高密度封裝方案
「TVOC」	指	總揮發性有機化合物，指同時存在於空氣中多種揮發性有機化合物的總濃度綜合檢測值，用作室內或環境空氣質量的整體指標

---

## 詞彙表

---

「TWS」	指	真無線立體聲，為一項無線音頻技術，透過藍牙連接實現耳機完全無線化，左右耳機各自獨立輸成立體聲音訊，兩耳機之間無需任何線纜連接
「UAV」	指	無人駕駛航空器，指透過遙控或自主飛行系統操作的無人飛行器，通常稱為無人機，應用範疇包括航拍、測繪、配送、農業及軍事偵察等
「UL」	指	保險商實驗室，為全球獨立安全科學機構，為多個行業的產品、零部件及系統提供安全、質量及可持續發展合規性的測試、認證及驗證
「UV」	指	紫外線(激光)，指發射紫外線光譜的激光，波長短於可見光(一般為355納米或以下)，憑藉波長短、對周邊區域熱損傷極小的特點，用於材料高精度微細切割及加工
「XPO」	指	擴展封裝光學器件，為新興光模塊封裝架構，其延伸共封裝光學器件概念，在光引擎相對於交換機專用集成電路的布局及集成方面具備更強設計靈活性